

miniPFE 100 / 200

Cella pulita fisica di precisione



Attrezzatura in grado di lavorare in automatico in continuo le superfici superiore e inferiore di pezzi a forma di nastro

La cella piccola che utilizza una pistola larga viene utilizzata per l'industria elettrica come circuiti stampati o semiconduttori. Elaborando uniformemente su entrambi i lati, può applicare la forma dell'asta e la forma del foglio. Applicabile per piastra in ceramica e Cu.

Caratteristica

- Le funzioni sono integrate, ma la sua qualità di lavorazione della sabbiatura a umido rimane invariata. Cella di nuova concezione come scopo di piccole dimensioni e risparmio di costi.
- Le parti compatte di sabbiatura e risciacquo con acqua facilitano la manutenzione degli attuatori; semplicemente aprendo un coperchio del trasportatore. Anche il cannone largo e la pompa come parti principali, conservano ancora l'elevata durata originaria.
- Gamma di 2 tipi (MiniPFE 100/200) a seconda delle dimensioni del pezzo.

Spec

mini PFE 100

Misurare	1200 (L) × 1250 (P) × 1600 (A) mm
Dimensione del lavoro	Larghezza: 20-100 mm Lunghezza: 100-250 mm Spessore: 0,1-1,5 mm
Velocità di trasporto del trasportatore	0.1~3.0m/min
Pistola	Wide Pistola 110mm Uno ciascuno per la parte superiore e inferiore
Alimentazione elettrica	AC200V, 50/60Hz, 3 fasi
Consumo di energia	Circa 2,6 kW (potenza apparente nominale totale di tutte le apparecchiature)
Pressione di alimentazione dell'aria	0,5MPa-0,7MPa
Consumo d'aria	4,1 m ³ /min (NTP a 0,25 MPa della pressione dell'aria preimpostata)

miniPFE 200

Misurare	1200 (L) × 1650 (P) × 1650 (A) mm
Dimensione del lavoro	Larghezza: 20-200 mm Lunghezza: 100-250 mm Spessore: 0,1-1,5 mm
Velocità di trasporto del trasportatore	0.1~3.0m/min
Pistola	Wide Pistola 220mm Uno ciascuno per la parte superiore e inferiore

Alimentazione elettrica

AC200V, 50/60Hz, 3 fasi

Consumo di energia

Circa 4.3kW (Potenza nominale apparente totale di tutte le apparecchiature)

Pressione di alimentazione dell'aria

0,5MPa-0,7MPa

Consumo d'aria

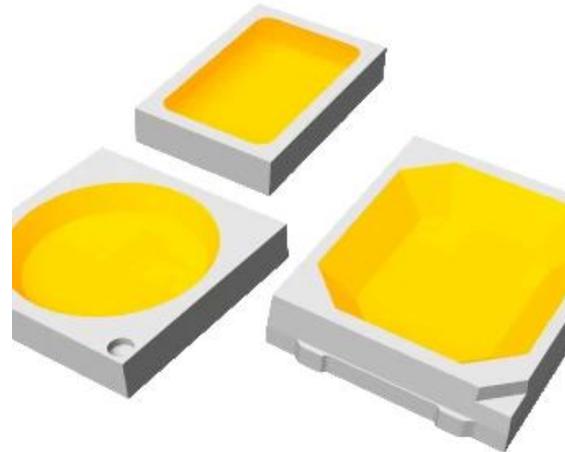
7,7 m³/min (NTP a 0,25 MPa della pressione dell'aria preimpostata)

Pagine correlate

Applicazioni correlate



[Pretrattamento per la galvanica per eliminare le bave senza danneggiare i semiconduttori \(sbavatura\)](#)



[Metodo di rimozione della resina sovrastampata che riduce drasticamente i danni al chip LED sepolti](#)



[Metodo di lavorazione per rimuovere bave sottili \(bave flash\) senza danneggiare il pacchetto LED](#)